

VACUUM - PVD THIN FILMS - LEAK TESTING - PLASMA

PVD - AC & DP



allianceconcept



Fort de plus de 30 ans de savoir-faire en matière de technologie sous vide et des procédés de pulvérisation cathodique, nous proposons dans nos équipements AC & DP nos propres sources magnétron de diamètre, 75, 100, 150 et 200 mm dans des configurations sputter up, down, planar et co-focale.

Nous offrons aussi à nos clients la possibilité d'intégrer **des sources de plus grandes dimensions**, ou équipées avec champ tournant ou arrangements magnétiques particuliers pour répondre à leurs exigences les plus pointues. Notre **PVD Lab** est à votre disposition pour réaliser **essais** et **preuves de concept**, étape nécessaire de votre processus de décision. Ces équipements sont **évolutifs** vers notre solution clustertool CT200 vous ouvrant **le champ des possibles**.

Bâtis gamme AC & DP

AC 450 CT

Flexibilité & Précision



DP 650 / 750 / 850 / 1100

Polyvalence & Modulable



CT 200

Performance & Adaptabilité





Variantes

Porte-substrats

- Préparation de surface par plasma RF
- Refroidi
- Chauffant



Intégration

- Passe-paroi
- Boîte à gants
- Salle blanche
- Basement



Cathodes développées en interne, compatibles DC, RF, DC+, HIPIMS.

Implantation optimisée selon l'environnement dans lequel sera installé votre équipement.

	AC450CT	DP 650/750/850/1100
Diamètre chambre	500 mm	650mm / 750mm / 850mm / 1100mm
Source de pulvérisation	Cathodes 75 ou 100mm	Cathodes 150 ou 200mm
Nombre de sources	4x100mm ou 6x75mm	Dépend de la taille de chambre
Technologie	Magnétron, tiltée	Magnétron ou diode, planar
Polarisation cathodes	DC / DC + / RF / HIPIMS	
Type de dépôt	Pulvérisation conventionnelle ou réactive	
Zone utile (uniformité de dépôt +/-5%)	>200mm (cathodes 100mm)	150mm (cathode 200mm)
PEM (Plasma Emission Monitor)	Oui, optionnel	
Etching RF	Oui, adaptation d'impédance automatique	
Sas	Sas monoplaque à transfert automatique	
Pompage Sas	Primaire sec, secondaire turbomoléculaire	
Dimension substrat	200mm max.	
Pompage enceinte de dépôt	Secondaire cryogénique ou turbomoléculaire, primaire sec	
Vide limite, pompage turbomoléculaire	5.10 ⁻⁷ mbar [1]	
Vide limite, pompage cryogénique	5.10 ⁻⁸ mbar [1]	
RGA (Residual Gas Analyser)	Oui, optionnel	
Pilotage	Automatique AC3000	
Ouverture chambre	180°, motorisée	Translation platine supérieure + rotation
EVo CT200	Oui	

1- Valeurs mesurées sur équipements et pas simulées, configuration turbomoléculaire

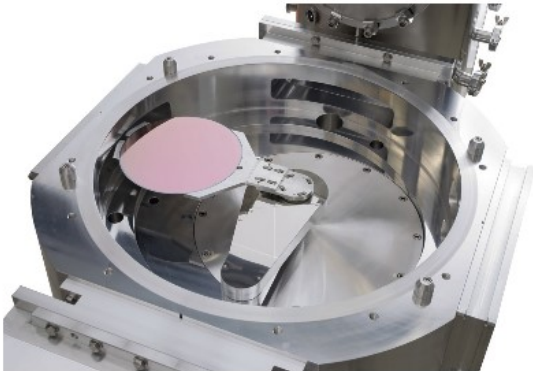
2- Valeurs mesurées sur équipements et pas simulées, configuration cryogénique

3- Uniformité calculée selon formule $U(\%) = [(E_{\max} - E_{\min}) / (E_{\max} + E_{\min})] \times 100$



Une infinité de possibilités

CLUSTERTOOL CT200, système de synthèse de couches minces avec configuration multi-chambres. Outil ultime d'élaboration de couches minces, CT200 est l'un des clustertools les plus polyvalent du marché.



- Sas à cassette
- Chambre avec robot de transfert sous vide, carrée ou hexagonale
- Multi-modules et multi-techniques (interface SEMI)
- Chambre de retournement
- Intégration module ou équipements autres

CT200 est l'accomplissement de plus de 30 ans dans la construction de dépôt de couches minces par pulvérisation cathodique magnétron. Son **évolutivité** combinée à ses **interfaces SEMI** autorise **toutes les possibilités**.

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE



4 AVENUE DU PONT DE TASSET
74960 ANNECY - FRANCE
TÉL. : +33 (0)4 50 57 93 85

CONTACT@ALLIANCE-CONCEPT.COM
WWW.ALLIANCE-CONCEPT.COM

